

MD-HM01

厚膜多层介质浆料

产品介绍

MD-HM01是一款用于多层电路的绝缘体层之间的绝缘体。它通过丝网印刷应用于陶瓷基板，并在传送带炉中在空气(氧化)气氛中烧制。

典型性能

烧结厚度 (μm)	40-50 (3~4次印刷烧结,325目-网筛)
介电常数 (K)	7-9
介电损耗(%)	<0.5
绝缘电阻	>10 ¹² Ω at 100 VDC
击穿电压 (VDC/25μm)	>400(25μm)

产品特点

绝缘性

与96瓷及其他导体有优异的
粘接性

推荐工艺

基板: MD-HM01性能是基于96%氧化铝基板的测试。其他成分的基板和不同制造商的基板可能会导致性能属性的变化。

印刷: 推荐使用 325目不锈钢丝网,印刷速度可达 30厘米/秒,烧结总厚度应至少为40μm(1.6mil)。当使用325网筛时,可能需要三次单独印刷MD-HM01来实现该烧结厚度,每印刷一次烧结一次。打印刷应该在清洁通风的环境中经行,在 20-23℃环境中印刷浆料具有最佳的印刷性能。

干燥: 浆料印刷后,在室温下流平 5-10 分钟,然后在通风的烘箱或传送带式干燥炉中150℃干燥 10-15 分钟。

烧结: 烧结在具有通气的链式烧结炉中进行,使用60 分钟周期烧结曲线,峰值温度 850℃, 10 分钟。

产量和性能将在很大程度上取决于加工过程中的环境,特别是在丝网印刷过程中。应谨慎地保持介质成分、印刷丝网和其他工具不受金属污染。灰尘、棉纤维和其他特殊物质也可能导致产量下降。

存储和有效期: 浆料应在密闭的容器中清洁、温度稳定的环境中保存,温度小于 25℃。在没有打开容器的情况下,保质期为发货日期6 个月。长时间存放可能会发生固体物沉降,使用前进行充分搅拌。

安全与处理: 本产品含有有机溶剂和材料,在使用MD-HM01时应采取以下预防措施:

在有足够通风的情况下使用;

避免长时候接触皮肤避免长时候吸入蒸汽;

如接触皮肤,应立即用肥皂和水清洗患处;

吞食有危险;